



产品特点

- ◆ 基于 平台，采用双核处理器
- ◆ 铝合金材料打造，整体采用表面喷砂氧化处理
- ◆ 无风扇散热设计
- ◆ 整机尺寸
- ◆ 应用于嵌入式工业控制、车载等领域

规格

主要规格	内存	<input type="text"/>
	硬盘	<input type="text"/>
		内部预留 <input type="text"/> 模块接口 <input type="text"/>
视频	接口	<input type="text"/>
	芯片	<input type="text"/>
网络	接口	<input type="text"/> 个 <input type="text"/> 网络接口 <input type="text"/>
	音频	<input type="text"/>
	速率	<input type="text"/>
	接口	后置 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> ，前置 <input type="text"/>
电源接口		<input type="text"/> ， <input type="text"/> 电压输入 <input type="text"/>
尺寸规格		<input type="text"/>
操作系统		<input type="text"/>
	其它	<input type="text"/>
工作环境	温度	<input type="text"/> °C
	湿度	<input type="text"/>